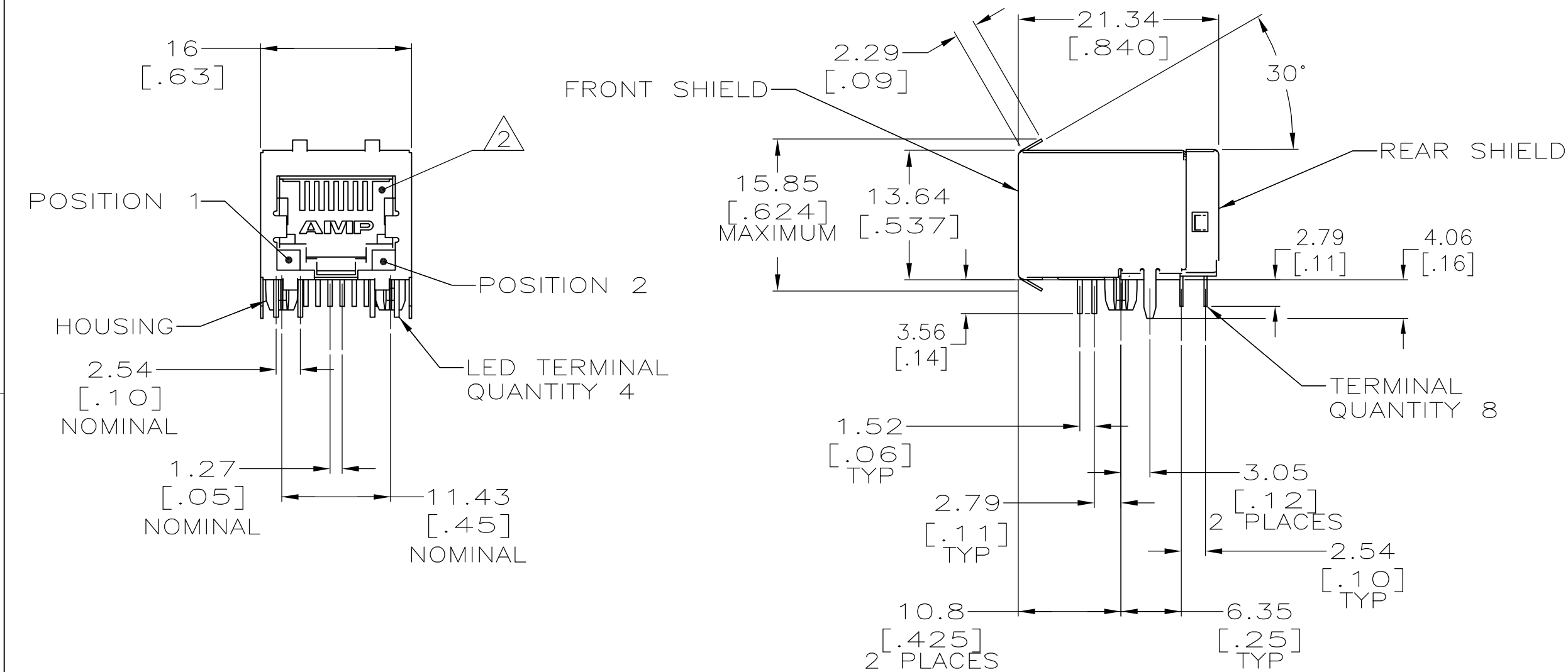
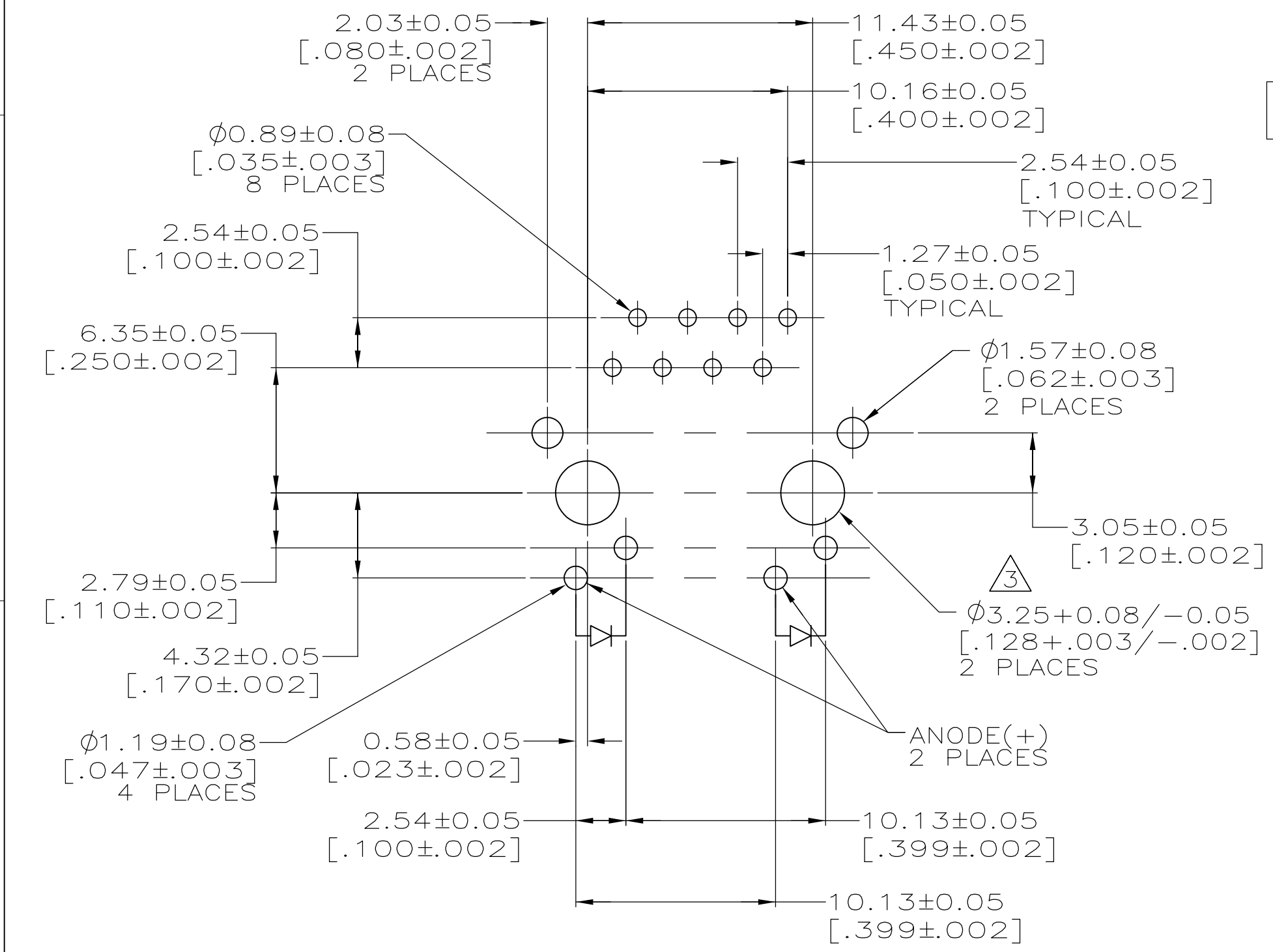
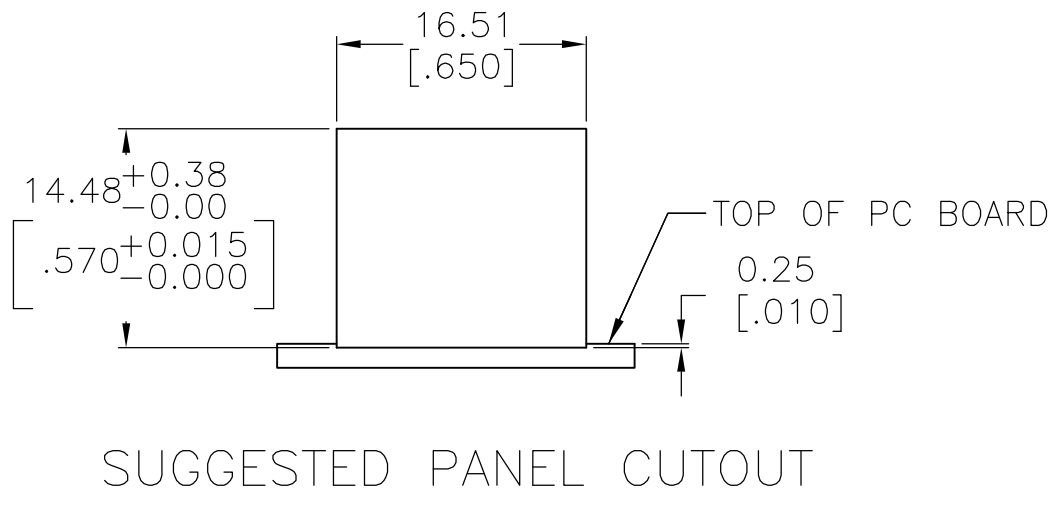


LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
AA	00		E2	REVISED PER ECO-11-005033	26MAR11	RK	HMR



- MATERIAL: HOUSING – PBT THERMOPLASTIC BLACK, UL94V-0.
TERMINALS – 0.33[.013] THICK PHOS BRONZE PLATED WITH 1.27 μ m[.000050] MINIMUM THICK HARD GOLD IN LOCALIZED AREA AND 3.81 μ m[.000150] MINIMUM THICK MATTE TIN IN SOLDER AREA OVER 1.27 μ m[.000050] MINIMUM THICK NICKEL UNDERPLATE.
SHIELDS – 0.25 [.010] THICK COPPER ALLOY PLATED WITH 1.27 μ m[.000050] MINIMUM NICKEL AND 2.03 μ m[.000080] MINIMUM HOT TIN DIP ON PCB GROUND TABS.

LIGHT EMITTING DIODE (LED) – DIFFUSED EPOXY LENS, 0.51 x 0.51[.020 x .020] CARBON STEEL WIREFRAME LEADS PREPLATED WITH 8.89 μ m[.0003500] THICK Sn/Cu OVER 2.03 μ m[.000080] THICK Ag OVER 1.02 μ m[.000040] THICK Cu OVER 3.56 μ m[.000140] THICK Ni OVER 1.02 μ m[.000040] Cu UNDERPLATE
- JACK CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND REGULATIONS, PART 68 SUBPART F.
- USE #30 DRILL BIT OR 3.25mm DRILL BIT WHEN PRODUCING THESE PCB HOLES.
- THIS MODULAR JACK WITH INTEGRATED LEDS IS NOT IR REFLOW SOLDERING PROCESS COMPATIBLE.



SUGGESTED PC BOARD LAYOUT
COMPONENT SIDE
SCALE 4:1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm [INCHES]

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	±	-
1 PLC	±	-
2 PLC	±	0.25[.01]
3 PLC	±	0.13[.005]
4 PLC	±	-
ANGLES	-	-
FINISH	±	-

MATERIAL

FINISH

DWN
L. VARELA - DOCK5
CHK
J. WESTMAN
APVD
S. FLICKINGER

07JUN2005
07JUN2005
07JUN2005

PRODUCT SPEC
108-1163
APPLICATION SPEC
114-2154
WEIGHT
-
CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

MODULAR JACK ASSEMBLY,
8 POSITION, RIGHT ANGLE, LOW PROFILE,
PANEL GROUND WITH LEDS

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C=5569564

RESTRICTED TO
-

SCALE
2:1

SHEET
1 of 1

REV
E2

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9